檔　號:
保存年限:

台灣發明商品促進協會 函

地址：台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：施養晨
電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國114年3月23日
發文字號：台發協字第1140032302號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(文稿1_0032302A00_ATTCH1.docx、文稿1_0032302A00_ATTCH2.pdf)

主旨：本協會辦理「2025韓國世界發明創意競賽」，由於活動日期更新敬請惠予公告並轉知 貴校師生踴躍參加

說明：

一、「2025韓國世界發明創意競賽」匯聚全球頂尖創新發明，參展作品超過600件，是發明家促進國際交流與商業合作的最佳平台。

二、展覽日期：114年7月17日至7月19日。

三、參展地點：首爾教育大學。

四、聯絡方式：wiipa168@wiipa.org.tw或02-8772-3898賴小姐。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學

電子文騎縫

國立清華大學
1140005615

大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：

電子公文
2025/03/24
08:20:47
交換章

施養隆 會長

裝
訂
線

公
換
章
74